

認証書付属書 (同板厚)

表1 認証試験板厚の溶接条件データ
 (最小及び最大ルート間隔の場合)

板厚 (mm)	最小、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
16	4～10テーパ	170～200	19～21	4.7～5.7	2
	10	170～210	19～22	2.5～4.3	
32	4～10テーパ	150～210	18～21	4.0～6.2	4
	10	150～210	18～21	2.4～4.0	

定常状態の溶接条件データ測定値を記載している。

表2 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲

板厚 (mm)	最小、6mm、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
16	4	130～220	16～23	3.1～7.0	2
	6	130～220	16～23	3.0～6.8	
	10	130～220	16～23	2.9～5.0	
19	4	130～220	16～23	2.3～7.0	2
	6	130～220	16～23	2.3～6.8	
	10	130～220	16～23	2.1～5.0	
22	4	130～220	16～23	2.3～7.0	2
	6	130～220	16～23	2.3～6.8	
	10	130～220	16～23	2.1～5.0	
25	4	130～220	16～23	2.3～7.0	2
	6	130～220	16～23	2.3～6.8	
	10	130～220	16～23	2.1～5.0	
28	4	130～220	16～23	2.3～7.0	3
	6	130～220	16～23	2.3～6.8	
	10	130～220	16～23	2.1～5.0	
32	4	130～220	16～23	2.3～7.0	4
	6	130～220	16～23	2.3～6.8	
	10	130～220	16～23	2.1～5.0	
36	4	130～220	16～23	2.3～7.0	4
	6	130～220	16～23	2.3～6.8	
	10	130～220	16～23	2.1～5.0	

パス数は、表2に記載の10%増までのパス数を認める(小数点以下は切り上げ)。

※この溶接施工条件範囲は、認証書に記載された溶接条件(80kJ/cm以下、パス間温度250℃以下)で使用しなければならない。

※鉄骨システムソフトウェア Ver 4 以降